Veranstaltungsort

Regensburg – das mittelalterliche Wunder Deutschlands!

Lernen Sie das junge Mitglied der UNESCO Welterbe-Stätten kennen und genießen Sie die bayerische Gastlichkeit.

ACHAT Plaza Herzog am Dom
Domplatz 3
93047 Regensburg

Organisation

Seminarmanagement
Dipl.-Phys. Helmut Reff

OTTI, Seminare und Fachforen
Bereich Technik
Wernerwerkstraße 4
93049 Regensburg

Telefon +49 941 29688-34
helmut.reff@otti.de

Zimmerreservierung

ACHAT Plaza Herzog am Dom
Telefon +49 941 58400

Sonderkonditionen für OTTI-Seminarteilnehmer!

www.achat-hotel.de

Hotel Bischofshof am Dom
Telefon +49 941 58460

Sonderkonditionen für OTTI-Seminarteilnehmer!

www.hotel-bischofshof.de

oder
Tourist-Information Regensburg

Telefon +49 941 507-4412
www.regensburg.de

Teilnahmegebühren und Leistungen

Bei Anmeldung bis zum 27.04.2010:
Pro Person: € 890,00

Bei Anmeldung danach:
Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

Unternehmen aus Oberfranken, Niederbayern und der Oberpfalz: € 910,00

Der zweite Teilnehmer Ihrer Firma erhält **10 % Ermäßigung**, jeder weitere Teilnehmer Ihrer Firma erhält **20 % Ermäßigung**.

In der Teilnahmegebühr sind Pausengetränke, zwei Mittagessen, eine Stadtführung, ein Abendessen sowie ausführliche Tagungsunterlagen (auch auf CD!) enthalten.

Einträge löschen

Anmeldung versenden

OTTI-plus

Wichtige Kontakte knüpfen, Inhalte diskutieren, zwanglos Netzwerke aufbauen – nutzen Sie dafür das OTTI-Rahmenprogramm. Ein Abendessen im Kreise der Teilnehmer und Referenten, eine Stadtführung oder eine Besichtigung bieten Ihnen Freiraum für das Vertiefen von Fachfragen und das Aufgreifen von innovativen Ideen.

Anmeldung per Fax: +49 941 29688-19

Ja, ich nehme teil am OTTI-Fachforum Technologien des Lötens

☐ **23. bis 24. Juni 2010 in Regensburg** (LOT 3603)

Name

Vorname | Titel

Telefon | Telefax

E-Mail

Abteilung/Funktionsbereich

Firma/Institution

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)

Firma/Institution

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Branche | Zahl der Mitarbeiter

☐ Unternehmen aus Ostbayern

OTTI-Kundennummer | USt-IdNr.

Datum | Unterschrift

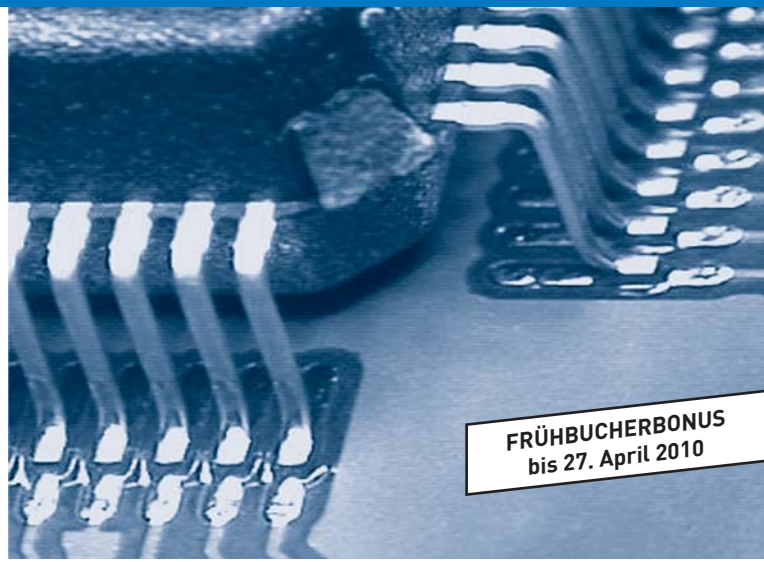
Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI), Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist. Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich OTTI vor. Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 120,00. Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.

V-B-2010-03-08 www.otti.de

OTTI-Fachforum



Technologien des Lötens

Grundlagen, Materialien und Verfahren

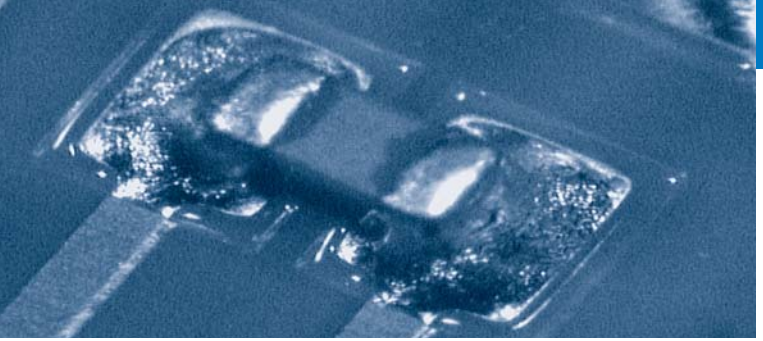
23. bis 24. Juni 2010 in Regensburg

Partner

PRODUKTION VON LEITERPLATTEN UND SYSTEMEN

OTTI Training Seminare Tagungen

www.otti.de



Fachforum

Technologien des Lötens

23. bis 24. Juni 2010 in Regensburg

- Metallurgische Grundlagen des Lötens
- Eigenschaften von Loten, Lotpasten und Flussmitteln
- Restriktionen bei Materialien und Bauelementen
- Methoden und Trends der Löttechnologien Reflowlöten, Wellenlöten, Selektivlöten, Handlöten
- Know-how zum bleifreien Löten
- Zuverlässigkeit von Lötstellen

Über 200 Veranstaltungen auf www.otti.de

Expertenwissen für Ihren Erfolg – profitieren Sie von praxisrelevanten Informationen durch sorgfältig ausgewählte Referenten und den erprobten Qualifizierungskonzepten in den OTTI-Veranstaltungen. Informationen zu allen aktuellen Seminaren, Fachforen und Tagungen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.otti.de**

Programm

1. Tag, 09:00 bis 17:10 Uhr:

1. Trends in der Verbindungstechnologie
- Miniaturisierung von Bauelementen und Strukturen
- System-Integration
- Neue Materialien, z.B. Nano- und Polymerelektronik
- Neue Anwendungen, z.B. für hohe Temperaturen

Prof. Mathias Nowottnick

2. Grundlagen des Weichlötens
- Werkstofftechnisches Basiswissen
- Mechanismen des Lötvorgangs
- Eigenschaften verschiedener Lote

Dipl.-Ing. (FH) Günter Grossmann

3. Eigenschaften von Lotpasten und Flussmitteln
- Aufbau und Wirkungsweise von Lotpasten
- Eigenschaften der Flussmittel
- Benetzungseigenschaften
- Normen und Standards

Dr. Werner Kruppa

4. Lötbarkeit von Bauelementen
- Trends bei IC-Packages und passiven Bauelementen
- Lötwärmebeständigkeit und Bedeutung der Feuchtigkeitsklassifizierung (MSL)
- Besonderheiten beim QFN Löten

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Lange

5. Schablonendruck
- Grundlagen und Anforderungen an die Materialien
- Anforderungen a. d. Equipment
- Schablonendruck für neue Technologien

Dipl.-Ing. (FH) Harald Grumm

6. Charakterisierung von Leiterplattenoberflächen
- Schichtaufbau und Eigenschaften von LP-Oberflächen
- Prozesszuverlässigkeit und Risikofaktoren
- Benetzungsverhalten und Lotausbreitung
- Neue Oberflächen

Dipl.-Ing. Ralf Schmidt

Stadtführung und Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Abendessen

2. Tag, 08:30 bis 15:50 Uhr:

1. Reflowlöten
- Allgemeine Anforderungen an die Temperaturprofile
- Normen
- Eigenschaften verschiedener Reflowlötverfahren
- Vapourphase vs. Konvektion
- Löten unter inerten Bedingungen

Dr. Hans Bell

2. Wellen- und Selektivlöten
- Grundlagen und Trends bei den Verfahren
- Flussmittelauftrag und Vorheizprozess
- Einfluss des Baugruppendesigns
- Ausblick und künftige Entwicklungen

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Friedrich

3. Lötwärmebeständigkeit von Basismaterialien
- Eigenschaften von Basismaterialien
- Lötwärmebeständigkeit
- Delamination von Leiterplatten
- Verwindung und Wölbung
- DK-Hülsenabrisse

Dipl.-Ing. Lothar Oberender

4. Hand- und Reparaturlöten
- Metallurgie des Handlötens
- Prozessfenster und Prozessoptimierung beim Hand- und Reparaturlöten
- Anforderungen an die Geräte und Materialien
- Normen

Dr.-Ing. Thomas Ahrens

5. Ursachen von Baugruppenausfällen
- Mangelhafte Leiterplatten
- Bauelementefehler
- Designfehler
- Unsachgemäße Handhabung

Dipl. Ing. (FH) Oswald Maurer

6. Zuverlässigkeit von bleifreien Lötstellen
- Deformation von Weichloten
- Degradationsmechanismen
- Zuverlässigkeit von Loten

Dipl.-Ing. (FH) Günter Grossmann

Ihre fachliche Leitung

Dr. Hans Bell
Rehm Thermal Systems GmbH, Blaubeuren-Seißen

Herr Dr. Bell war nach dem Studium der Physik/Kristallographie in Berlin zuerst im Applikationszentrum Berlin tätig. Er hat dann mehrere Jahre im Werk für Fernsehelektronik (Optimierung und Weiterentwicklung von Fertigungstechnologien für optoelektronische Bauelemente) verantwortlich gearbeitet.

Bis Ende 1999 war Herr Dr. Bell als Fertigungstechnologe für die DeTeWe (produktionsorientierte Aufgaben der Weiterentwicklung der Verbindungstechnologien, insbesondere dem Weichlöten) tätig. Während dieser Zeit promovierte er an der TU München. Seit Januar 2000 ist er Mitarbeiter der Rehm Thermal Systems GmbH, und dort für die Entwicklung und Technologie zuständig.

Ihre Referenten

Dr.-Ing. Thomas Ahrens
Geschäftsführender Gesellschafter, Trainalytics GmbH, Lippstadt

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Friedrich
Leiter Applikationstechnologie, ERSA GmbH, Wertheim

Dipl.-Ing. (FH) Günter Grossmann
Projektleiter, Eidgenössische Materialprüfungs-und Forschungsanstalt EMPA, Dübendorf/Schweiz

Dipl.-Ing. (FH) Harald Grumm
Leitung Applikation, Christian Koenen GmbH, High Tech Stencils, Ottobrunn-Riemerling

Dr. Dipl.-Chem. Werner Kruppa
Leitung Forschung und Entwicklung, Stannol GmbH, Wuppertal

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Lange
SMTS, High Performance Analog Europa Packaging/Reliability, Texas Instruments Deutschland GmbH, Freising

Dipl.-Ing. (FH) Oswald Maurer
Geschäftsführung, WEPTECH elektronik GmbH, Landau

Prof. Dr.-Ing. Mathias Nowottnick
Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik, IGS – FB Elektrotechnik, Universität Rostock

Dipl.-Ing. Lothar Oberender
Leiter Technologie, Häusermann GmbH, Gars am Kamp/Österreich

Dipl.-Ing. Ralf Schmidt
Plating & Surface Finishing, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Arbeitsvorbereitung/Technologie, Konstruktion, Entwicklung und Qualitätsmanagement
- Mitarbeiter der Baugruppen-Fertigung